

低反り・低弾性の ドライフィルム型封止材料

Low warpage · low modulus dry film type molding material



熱硬化型封止フィルム Zaristo Series

Thermal-curing type molding film

特 長 Features

- **超低反り**
Super-low warpage
- **低熱膨張、低弾性**
Low CTE, Low modulus
- **流動性の異なる2タイプをラインナップ**
Providing two different fluidity types of products
 1. 低流動性/中空封止用: Zaristo 909S (量産品)
Low-flow type for hollow molding: Zaristo 909S (Mass production)
 2. 高流動性/埋め込み封止用: Zaristo 917XS (開発品)
High-flow type for filling molding: Zaristo 917XS (Under development)

特 性 Properties

Warpage after cure on thin CCL

Test Coupon	Conventional	Zaristo
100μm DF 200μm CCL		No warping

部品の寸法安定性向上

X-section after molding

Zaristo 909S	Zaristo 917XS
Zaristo Chip 中空構造形成可能	表面平滑性良好: Flat surface 下地の凹凸の影響無し

Material property	Unit	Zaristo 909S	Zaristo 917XS
Tg (TMA)	deg.C	> 150	> 150
CTE α1	ppm/deg.C	16-18	7-10
Young's modulus	GPa	6-7	7-9

用 途 Application

- Zaristo 909S: SAW Filter, Molding
- Zaristo 917XS: MIS, ETS, Molding